

京都産学公共同研究拠点「知恵の輪」先端光加工プロジェクト 京都レーザーテックオープンデー 開催案内



【日 時】 令和2年2月17日（月）（13時00分より受付）
13時30分～17時00分

【場 所】 京都大学大学院工学研究科 イノベーションプラザ棟2階 会議室
（京都市西京区御陵大原1-30 京大桂イノベーションパーク内）

【対 象】 超臨界洗浄・乾燥技術に関心をお持ちの事業者

【参加費】 500円（技術交流会費を含む）

【主 催】 京都市，次世代レーザープロセッシング技術研究組合，
（公財）京都高度技術研究所

【定 員】 20名（先着順）

【講 師】 株式会社レクザム 営業本部 三宅 幸一 氏

【スケジュール】

- | | |
|-------------|--|
| 13：00～ | 開場・受付 |
| 13：30～13：35 | 主催者挨拶 |
| 13：35～13：50 | 先端光加工プロジェクトの概要説明 |
| 13：50～14：50 | 「超臨界CO ₂ による乾燥および洗浄技術」
<休憩 10分間> |
| 15：00～16：00 | 「超臨界乾燥装置を用いた活用事例」 |
| 16：00～17：00 | 技術交流会 |



(株)レクザム製『卓上型SCRD4』

【申込方法】 「オープンデー参加希望」と題したメールに以下の内容を添えてください。
1. お名前 2. 所属・役職 3. 連絡先（電話番号、E-mail アドレス）
（申込み先 E-mail アドレス：info@laserprocessing.jp）

【問い合わせ先】 次世代レーザープロセッシング技術研究組合 事務局（担当：広本）

URL: <http://www.laserprocessing.jp/>

TEL: 075-381-7990